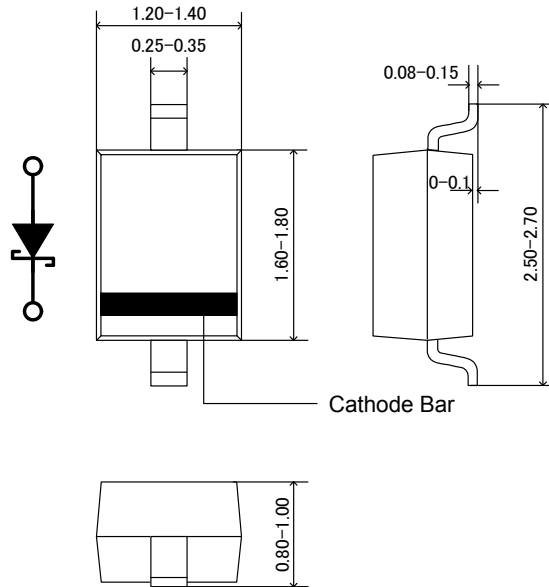


Packaging Information / Reference Pattern Layout Dimensions

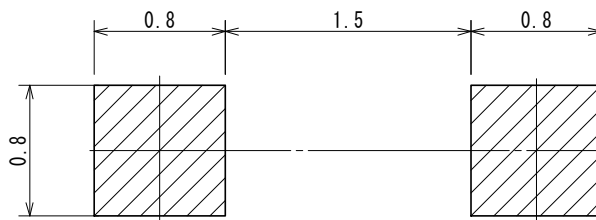
● SOD-323A

Unit: mm

■ Packaging Information



■ Reference Pattern Layout Dimension



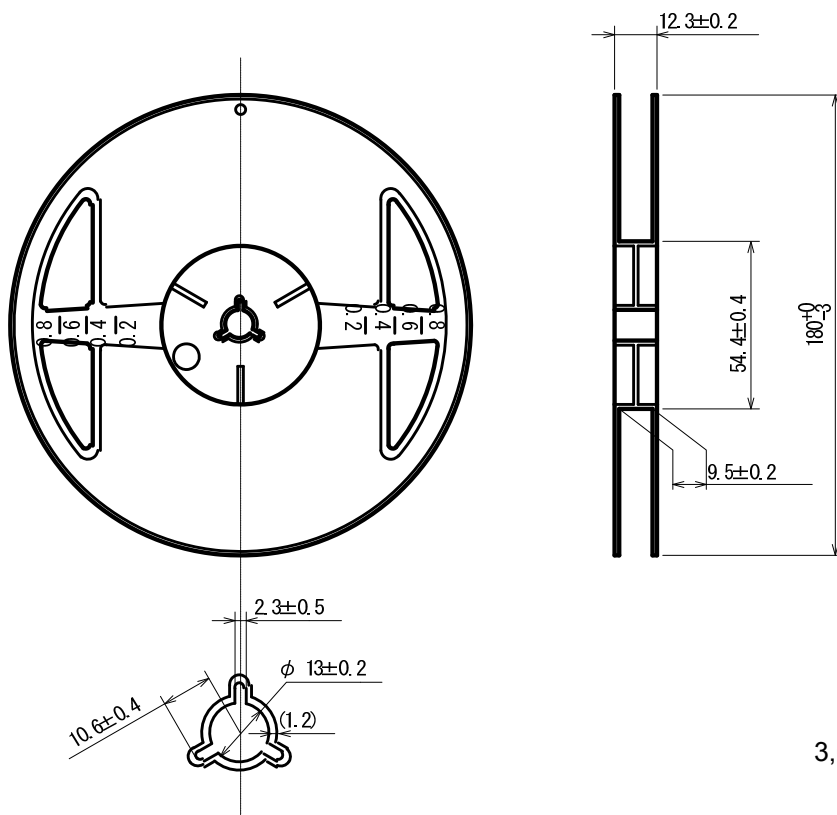
Thickness of solder paste: 150 μm(reference)

テーピング仕様 / Taping Specifications

SOD-323A

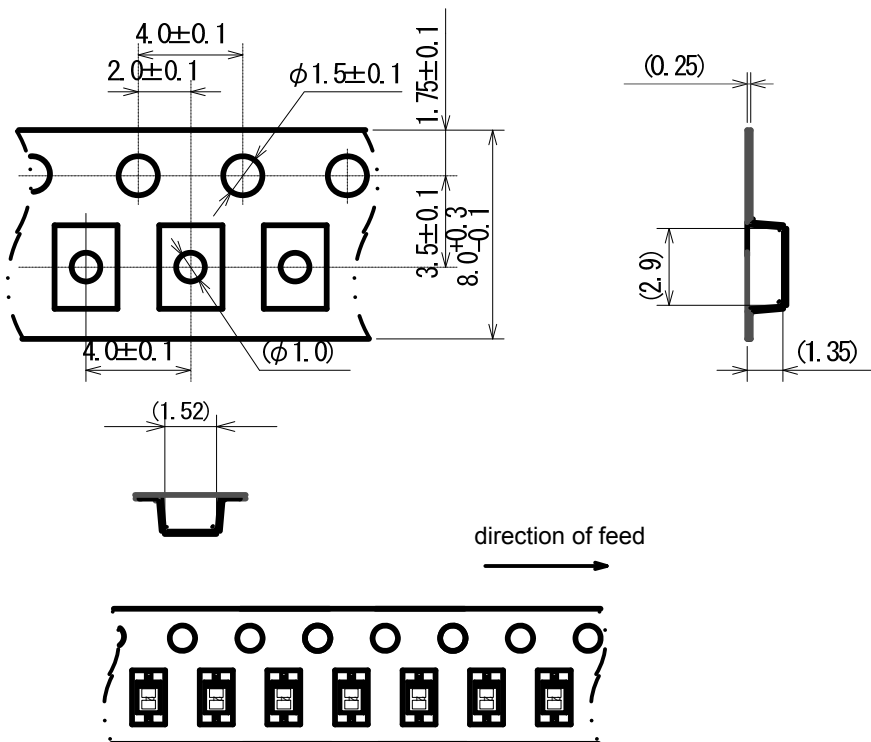
Unit: mm

●リール/Reel



3,000pcs/reel

●テーピング仕様/Taping Specifications

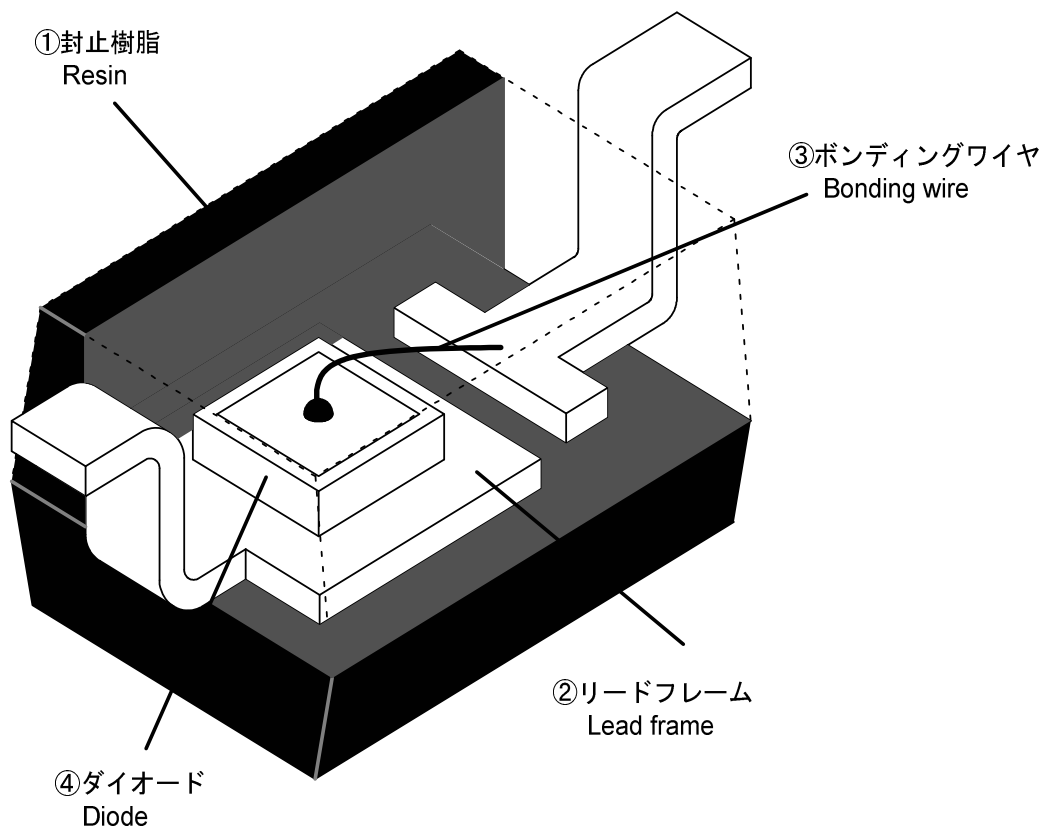


R Type : [Device orientation : Right]

Standard feed

SOD-323A 構造図  
SOD-323A Perspective

RoHS対応品  
RoHS Compliance



項目 Item	材料 Material	備考 Note
① 封止樹脂 Resin	エポキシ樹脂 Epoxy resin	難燃グレード/Flammability rating UL94V-0
② リードフレーム Lead frame	Fe-Ni系 Fe-Ni alloy	
	端子処理 Lead plating	鉛フリーはんだメッキ Lead(Pb) free solder plating
③ ボンディングワイヤ Bonding wire	Au	
④ ダイオード Diode	Si	

捺印表示 Marking	レーザー Laser marking
-----------------	-----------------------

※ダイアタッチは金共晶接合  
Au eutectic alloy is used for die attachment.